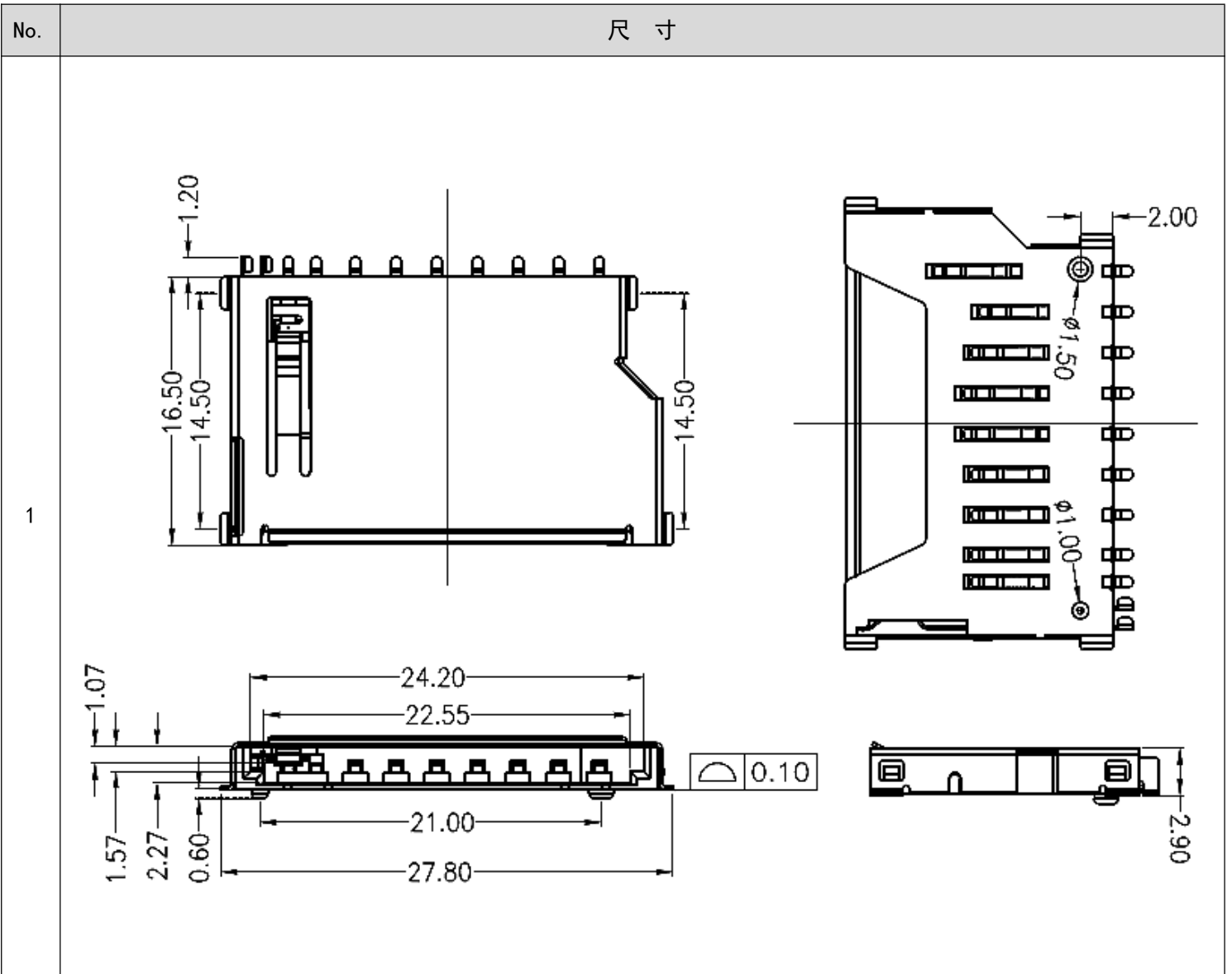
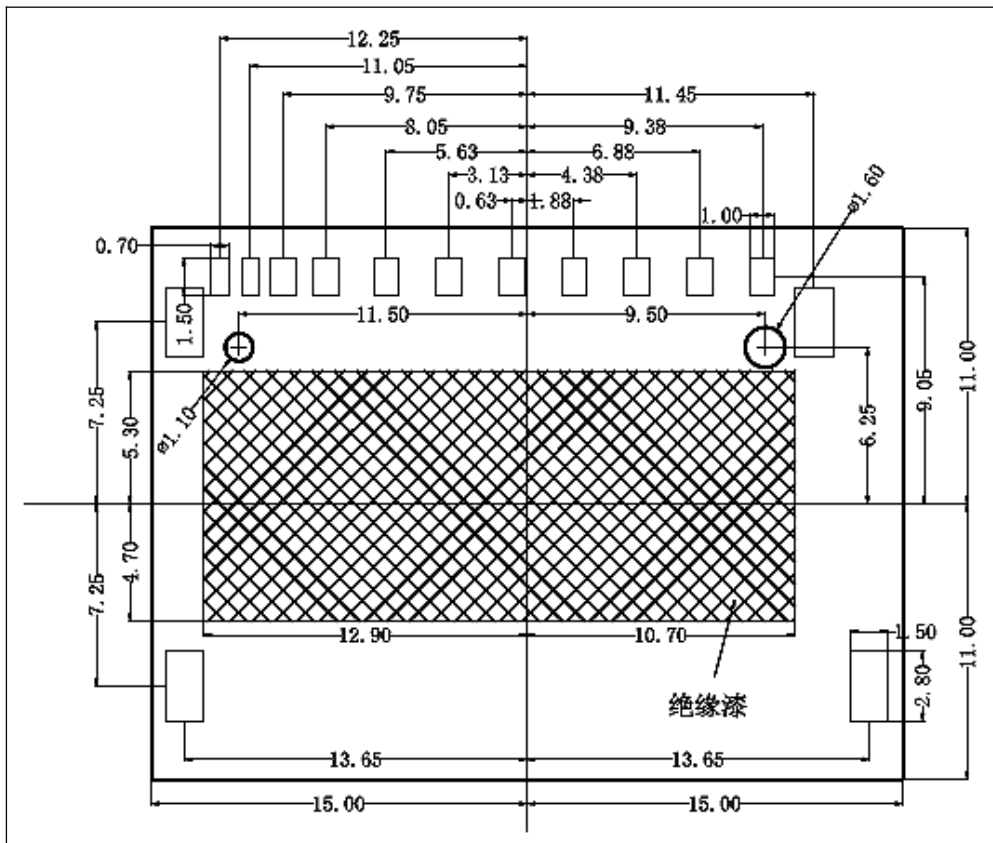


■ 外形尺寸



■ 电路图[A向]



■ 端子[引脚]



■ 使用参数

项目		等级			
		A级[产品]	B级[产品]	C级[产品]	
电气性能	初期接触电阻	50mΩ max.	30mΩ max.	30mΩ max.	
	绝缘电阻	100mΩ min. 100V DC Skey/PD: 50mΩ min. 100V DC			
	耐电压	150V AC for 1min	100 V AC for 1min		
机械性能	端子强度	3N for 1 min.	2N for 1min.		
	操作强度	工作方向	500gf ± 0.3N.		
		拉引方向	500gf [500]		
	耐振性能	10N	6N [条件: 全振幅 1.5mmX, Y, Z 方向 2H]		
	焊接耐热	手工焊接	350±10°C 3+ ¹ S	300±10°C 3+ ¹ S	
		浸焊	270±10°C 10+ ³ S	260±5°C 10+ ³ S	260±5°C 5+ ³ S
		回流	260°C max 20S max	255°C max 10S max	255°C max 10S max
最大额定[电阻负荷]		50V 20mA	30V 0.2A	30V 0.2A	
使用温度范围		-10°C to +60°C			
耐久性能	无负荷寿命	10,000 Cycles	8,000 Cycles	6,000 Cycles	
	负荷寿命 [额定负荷]	8,000 Cycles 50mΩ max.	6,500 Cycles 30mΩ max.	4,000 Cycles 30mΩ max.	
耐环境性能	耐寒性能	-40±2°C for 96h	-20±2°C for 96h		
	耐热性能	85±5°C for 96h	75±5°C for 96h		
	耐湿性能	40±2°C, 90 to 95% RH for 96h			

■ 焊接条件

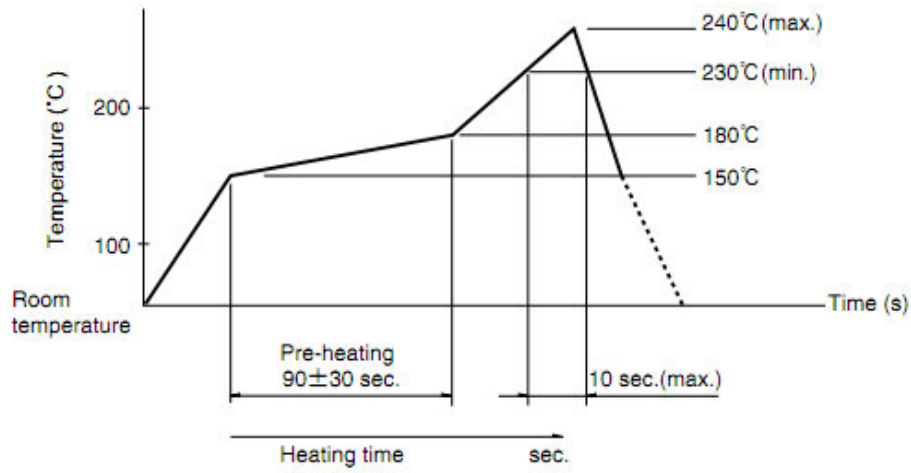
手焊式

项目	条件
焊接温度	350°C max.
连续焊接时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

回流焊

[适用表面贴装型产品]

1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2的CA(K)或CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。
3. 固定方式: 采用耐热胶带。
4. 温度分布: (图 2.15)



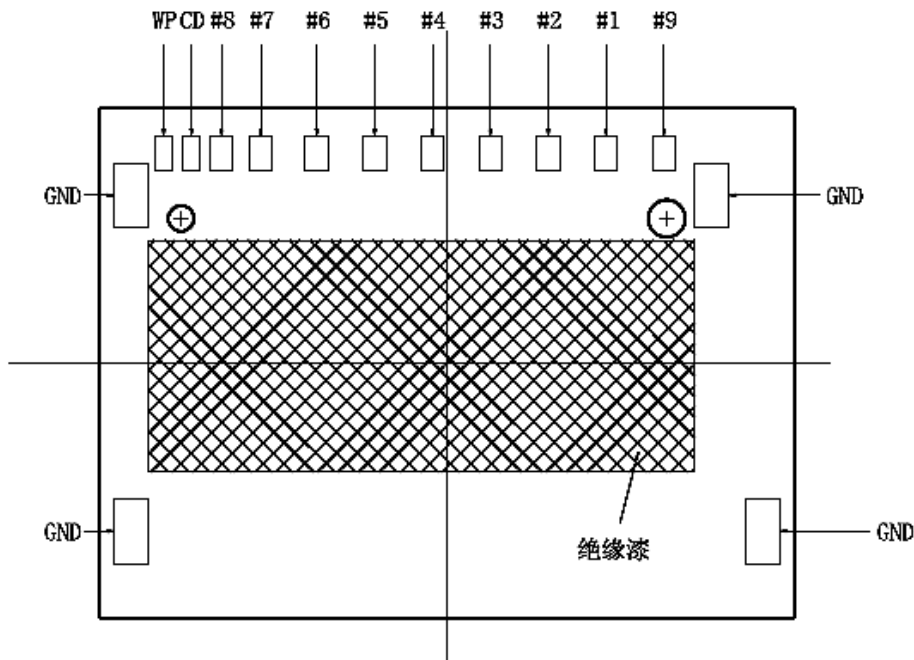
请根据各产品的产品规格书确认温度曲线。

2. 15

浸焊式

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2次以下

■ 引脚定义



PIN NO.	NAME	DESCRIPTION
1#	CD/DAT3	CARD DETECT
2#	CMD	COMMAND
3#	VSS1	GROUND
4#	VDD	POWER
5#	CLK	CLOCK
6#	VSS2	GROUND
7#	DAT0	DATE I/O
8#	DAT1	DATE I/O
9#	DAT2	DATE I/O